

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TRULY®

TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

須予披露交易 增資協議

茲提述該等公告，內容有關訂立股東協議以成立合資公司及增加合資公司之註冊資本。

增資協議

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月五日，本公司之間接全資附屬公司信利半導體與惠州仲愷及惠州投資(即股東協議之原有訂約方)訂立增資協議，以增加合資公司之註冊資本。

根據增資協議，訂約方同意將合資公司之註冊資本由人民幣2,300,000,000元增加至人民幣2,682,641,157元；信利半導體就此同意注資合共人民幣410,000,000元，其中人民幣382,641,157元將作為合資公司之額外註冊資本，餘下人民幣27,358,843元則撥入合資公司之資本公積。完成增資後，合資公司將由信利半導體、惠州仲愷及惠州投資分別持有59.7039%、23.5216%及16.7745%。

上市規則之涵義

由於增資協議項下交易之若干適用百分比率超過5%但低於25%，故增資協議項下交易根據上市規則構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則之申報及公告規定。

茲提述該等公告，內容有關訂立股東協議以成立合資公司及增加合資公司之註冊資本。

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月五日，本公司之間接全資附屬公司信利半導體與惠州仲愷及惠州投資訂立增資協議，以增加合資公司之註冊資本。

增資協議

日期 二零一七年五月五日

訂約方 (1) 信利半導體
(2) 惠州仲愷
(3) 惠州投資

主旨 為配合合資公司之營運及潛在發展，訂約方同意增加合資公司之註冊資本。

根據增資協議，訂約方同意將合資公司之註冊資本由人民幣2,300,000,000元增加至人民幣2,682,641,157元；信利半導體就此同意注資合共人民幣410,000,000元，其中人民幣382,641,157元將作為合資公司之額外註冊資本，餘下人民幣27,358,843元則撥入合資公司之資本公積。惠州仲愷及惠州投資不會根據增資協議就增加註冊資本注入任何新資本。

增資協議之條款由訂約方公平磋商後釐定，而信利半導體之額外出資額乃經參考合資公司於二零一六年十二月三十一日之資產估值（由獨立專業估值公司評估）及合資公司之資本需求後得出。

完成增資後，合資公司將由信利半導體、惠州仲愷及惠州投資分別持有59.7039%、23.5216%及16.7745%，而合資公司仍為本集團之聯營公司。

信利半導體同意將合資公司結欠信利半導體之債務(乃以本公司內部資金提供予合資公司)等額資本化，從而償付人民幣382,641,157元(作為合資公司新註冊資本)及人民幣27,358,843元(作為資本公積)。

合資公司及信利半導體須於二零一七年六月三十日前完成資本化程序。

合資公司股東之
投票權 完成增資後，惠州仲愷須於緊隨合資公司成立後五年內轉授所擁有與經營及管理合資公司有關之23.5216%投票權其中7.2961%予信利半導體，致使信利半導體所擁有與經營及管理合資公司有關之投票權由59.7039%增加至67%。除非信利半導體同意，否則有關投票權比例不得更改。有關安排乃根據股東協議而作出，並於增資後繼續生效。

其他條款 除本公告披露者外，股東協議其餘所有條款將維持不變並繼續生效。

訂立增資協議之理由及裨益

本公司認為AMOLED極有可能成為次世代主流顯示技術，並已於二零一六年十一月投入批量生產AMOLED面板。增資協議項下進一步投資可增加合資公司之營運資金以便其持續研發AMOLED相關業務，並促進本公司有關新一代顯示技術之策略性目標。

因此，董事會認為訂立增資協議符合本集團利益。董事會(包括獨立非執行董事)認為，增資協議乃按一般商業條款訂立，且增資協議之條款屬公平合理，並符合股東整體利益。

由於概無董事於增資協議中擁有重大權益，故概無董事須就批准增資協議之相關董事會決議案放棄投票。

有關本集團之資料

本集團之主要業務為製造及銷售液晶體顯示器產品(包括觸控屏產品)及電子消費產品(包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健護理產品及電子設備)。

有關合資公司之資料

合資公司之主要業務為製造薄片電晶體面板及AMOLED面板。

合資公司於二零一六年十二月三十一日之經審核資產淨值約為人民幣2,414,000,000元。截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度之除稅及非經常項目前後虧損如下：

	截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度 人民幣百萬元 (經審核)	截至 二零一六年 十二月三十一日 止年度 人民幣百萬元 (經審核)
除稅及非經常項目前虧損	20	420
除稅及非經常項目後虧損	28	448

附註：上述合資公司財務資料乃根據中國財政部頒佈之適用企業會計準則及企業會計制度編製。

有關惠州仲愷及惠州投資之資料

惠州仲愷為惠州管理委員會全資擁有之國有企業，主要從事投資業務。

惠州投資為惠州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有之國有企業，主要從事投資業務。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，惠州仲愷及惠州投資以及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

上市規則之涵義

由於增資協議項下交易之若干適用百分比率超過5%但低於25%，故增資協議項下交易根據上市規則構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則之申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AMOLED」	指	有源矩陣有機發光二極管，一種半導體產品
「該等公告」	指	本公司日期為二零一三年十二月十七日及二零一四年十一月十一日之公告
「董事會」	指	董事會
「增資」	指	根據增資協議增加合資公司之註冊資本
「增資協議」	指	信利半導體、惠州仲愷及惠州投資所訂立日期為二零一七年五月五日之增資協議
「本公司」	指	信利國際有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「惠州投資」	指	惠州市投資控股有限公司，於中國註冊成立並由惠州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有之公司
「惠州仲愷」	指	惠州仲愷高新區投資開發有限責任公司，於中國註冊成立並由惠州管理委員會全資擁有之公司
「惠州管理委員會」	指	惠州仲愷高新技術產業開發區管理委員會，惠州仲愷之唯一股東

「合資公司」	指	信利(惠州)智能顯示有限公司，由訂約方根據股東協議於中國註冊成立之有限公司
「合資股東」	指	合資公司不時之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「訂約方」	指	信利半導體、惠州仲愷及惠州投資
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司不時之股份持有人
「股東協議」	指	信利半導體、惠州仲愷及惠州投資所訂立日期為二零一三年十二月十七日之股東協議，內容有關成立合資公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例賦予之涵義
「信利半導體」	指	信利半導體有限公司，於中國註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零一七年五月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張達生先生；非執行董事李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。